

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员	汇添富基金、易方达基金、博时基金、兴业基金、泰康基金、人保资管、太平基金、睿郡资管、红杉资本、中金公司、中信证券、国泰君安证券、瑞银证券、广发证券、东北证券、西部利得、北信瑞丰、宝盈基金、长城基金、东吴基金、国联基金、中邮证券、英谊资管理、东吴证券、甬兴证券、华源证券、诚通证券、丞毅投资、西南证券、鸿竹资管、华鑫证券、中天汇富基金、横琴智合远见、湘财证券、长城财富保险、正圆私募基金、三登资管、华福证券、珩生资管、耕霖资管、东方财富证券、国信证券、致合(杭州)资产、前海汇杰达理资本、中航证券、江信基金、开源证券、万和证券、中银证券、极灏私募基金、航天科工资管、大华大陆投资、东方阿尔法基金、果行育德、申万宏源证券、恒泰证券、国联产业投资基金、贵源投资、沅杨资管、橡果资管、东兴基金、瑞华投资、富安达基金、相聚资本、华西证券、亘曦私募基金、大家资产、景从资管
时间	2025年3月27日
地点	线上会议
接待人员	董事会秘书常亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司整体情况介绍</p> <p>2024年，公司实现营业收入3.02亿元，同比增长124%；实现归属于上市公司股东的净利润4,115万元，实现扭亏为盈；经营现金流量净额为1.73亿元，较去年同期增长约110%。</p> <p>主力业务大直径硅材料，营业收入增长约108%，达到1.74亿元。其中，16英寸以上产品占比52%。该业务毛利率同比增长14个百分点，达到64%。盈利能力恢复至行业领先水平；</p>

成长型业务硅零部件，营业收入增长215%，达到1.18亿元，占公司营业收入的比例约为40%。该业务在营业收入大幅提高的同时，盈利能力继续保持行业领先水平，成为公司业绩增长的第二曲线；

战略型业务8吋轻掺抛光硅片，评估认证工作按计划开展，降本增效工作取得实绩，初步取得了评估认证和经济效益的良好平衡。

一、大直径硅材料业务毛利率修复的原因

该业务毛利率修复的主要原因是原材料成本降低、产品结构优化以及一系列成本节俭措施取得成效。展望2025年，原材料价格有望继续保持低位运行，随着市场景气度回升及该业务相应的产能利用率提升，有望对该业务毛利率产生积极影响。

二、大直径硅材料业务展望

该业务与半导体周期相关性较高。2024年度，中美科技巨头对人工智能数据中心的资本开支，带动了先进制程高端芯片（如HBM、eSSD）的需求增加，拉动了存储类集成电路制造厂的开工率和资本开支，是公司大直径硅材料业务的终端需求。

当前公司在全球细分市场的产能和技术方面居于领先地位，盈利能力已经得到修复。公司将继续扩大大直径硅材料业务优势产品的先发优势，紧密跟踪全球市场先进制程设备的最新技术要求，一方面积极响应海外市场逐步复苏的需求，另一方面牢牢抓住快速增长的中国本土市场需求。通过深化技术研发与产能协同，公司将继续保持该主力业务在行业中的优势地位。

三、硅零部件的产品结构

根据行业信息，硅零部件产品可以按应用制程分为8吋和12吋，12吋的加工难度大于8吋；也可以按照产品形态功能分为下电极(Ring)、上电极(Shower Head)、结构件等，加工难度依次上升。

公司具备“从硅材料到硅零部件”的全产业链优势，硅零部件业务聚焦于技术难度较高的高端产品类型，已经在国产等离子刻蚀设备厂商取得良好应用。

四、硅零部件业务的订单、扩产计划及毛利率

2024年度，中国本土集成电路产能增长带动了下游国产等离子刻蚀机原厂出货，相应地拉动了公司作为硅零部件OEM厂商的出货，即硅零部件增量市场；其

	<p>次，中国本土集成电路厂商去年以来开工率持续提升，拉动了硅零部件存量市场。</p> <p>2025年，中国本土集成电路产能的高资本开支和高开工率，以及国产等离子刻蚀机厂商赶超国际先进水平的研发投入，有望带来持续需求，有利于公司硅零部件业务的快速发展。为保证客户订单的及时交付，公司将继续扩大生产规模，做好设备采购、安装调试，以及时响应客户需求并继续保持以高端产品为主的销售结构。</p> <p>五、半导体产业周期</p> <p>展望2025年，公司认为当前半导体产业正处于“换挡变速”的前夜：全世界连续数年的巨额研发费用和资本开支持续灌注，催生了可观的芯片制造及封装产能，不仅带动了设备、零部件、材料需求，还极大地降低了下游技术创新的财务成本和机会成本；年初以来，大语言模型，尤其是以DeepSeek为代表的开源模型的重大进展，打破了科技巨头对数据、算法、算力的“闭环”垄断，为包括中国在内的全球各地开发者获得强大且廉价的算力铺平了道路。因此，下游应用端的新一代主流消费电子产品，已经呈现百花齐放的态势：智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能可穿戴设备等等，名目繁多，日新月异。基于以上终端创新，假以时日，半导体产业上行周期将真正到来。</p>
附件清单	无
日期	2025年3月28日